

2015年全球半导体封装、测试行业市场规模与企业集中度情况分析

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2015年全球半导体封装、测试行业市场规模与企业集中度情况分析》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yiqiyibiao/234529234529.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

根据统计，2013年全球半导体封装与测试行业市场规模为496亿美元，近五年年复合增长率为6.9%，占全球半导体行业市场规模比值为19.7%。过去五年，封装测试环节在整个半导体产业中产值占比一直非常稳定。中国IC封装市场起步晚，但增速快，行业规模近年来占全球比例也在不断上升，2013年已高达36%。

图1：封装在IC产业中所占份额保持稳定

从目前全球封装测试产业的分布来看，主要集中在亚太地区，有5家厂商来自台湾，2家厂商来自新加坡，美国、日本和中国大陆各1家，并且Top5厂商合计市占率超过了50%，行业集中度很高，这和全球晶圆制造业企业分布紧密相关，台湾有台积电和联电两家晶圆制造大厂，新加坡有GlobalFoundries。

从集中度变化趋势来看，过去五年日月光的市占率基本维持在18%左右，行业Top5厂商的市占率则一直保持在51%左右，这表明封测行业龙头厂商基本保持和行业同步增长的状态。

图2：全球前十大封测公司集中在亚太地区(亿美元)

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yiqiyibiao/234529234529.html>